

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-4-29

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（____）
参与单位名称及 人员姓名	科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度数字芯片设计行业集体 业绩说明会
时 间	2026 年 4 月 29 日
地 点	公司办公室
上市公司接待 人员姓名	总经理：赵国光 财务总监、董秘：李广平
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">Q&A</p> <p>1、介绍下公司 2025 年的营收情况？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司坚持品牌客户战略，凭借领先的技术能力和优质的客户服务，不断开拓新客户和新应用，市场领先地位得到进一步巩固与提升。报告期内，公司实现营业收入 35.25 亿元，较上年同期增长 8.02%。分产品方面，普通蓝牙实现营业收入 4.29 亿元，较上年同期减少 17.98%；智能蓝牙实现营业收入 14.44 亿元，较上年同期减少 3.56%；其他产品实现营业收入 16.52 亿元，较上年同期增加 32.82%。感谢您的关注。</p> <p>2、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的研发，在智能可穿戴市场持续深耕，市场地位保持领先，2025 年，公司开拓了智能眼镜、无线麦克风、智能录音助手等新的低功耗智能硬件市场。随</p>

着 AI 技术的快速发展，智能硬件市场新机遇还将不断涌现，公司将依托在低功耗无线计算 SoC 领域的技术积累和前瞻性布局，为未来发展打开新的成长空间。感谢您的关注。

3、详细介绍一下贵公司未来三年的业务布局方向及未来增长点，端侧 AI 芯片 车载 AIPC 等领域是否有产品规划

尊敬的投资者，您好！公司专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的研发，核心技术持续迭代演进，保持业内领先，芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能硬件领域的各类低功耗无线智能终端。公司的使命与愿景是研发低功耗无线计算 SoC 芯片，构建万物互联的智慧生活。随着 AI 技术的快速发展，智能硬件市场新机遇不断涌现，公司将依托在低功耗无线计算 SoC 领域的技术积累和前瞻性布局，以智能音视频、传感器数据处理等需求为抓手，围绕终端智能化的发展趋势，在智能可穿戴及智能硬件领域纵深发展。感谢您的关注。

4、公司下一代旗舰 SoC BES6100 采用了双系统多核异构架构，在延续超低功耗感知域（M 核）的同时，引入了更高性能的计算域（A 核），可以支持多模态与 Agent 类应用的发展。想请教公司：对于高性能计算域，公司内部是如何界定其能力边界的（中短期）？更偏向于围绕特定多模态任务（如实时视觉环境理解）进行针对性优化，还是希望逐步支持更通用的端侧模型运行能力？在投入节奏上，公司预计该方向（性能域）从产品导入到在收入结构中形成“有意义占比”，大致需要经历多久的周期？谢谢！

尊敬的投资者，您好！报告期内，公司面向智能眼镜等低功耗智能终端市场，研发了新一代智能旗舰可穿戴 SoC 芯片——BES6100 系列。BES6100 在架构上分为低功耗域及高性能域两大核心域，其中高性能域集成多核 Cortex-A 处理器、多核 NPU 与 GPU，综合算力较上一代可穿戴芯片 BES2800 大幅提升，可满足 Linux/Android 系统运行及端侧 AI 模型的推理需求；芯片集成多核 ISP 与 VPU，支持实时高性能图像抓拍及视频录制。公司产品从导入客户到大批量出货，通常需要 1 年左右时间，

	<p>并可保持约 3-5 年的销售期。感谢您的关注。</p> <p>5、在 AI 时代是不是语音的交互要远远大于之前传统的触控我的判断不符合 AI 的时代对蓝牙的需求？您认为 AI 的到来恒玄应该做些什么事情？</p> <p>尊敬的投资者，您好！端侧 AI 硬件作为 AI 技术与硬件深度融合的重要载体，在创新浪潮中将迎来新的发展机遇。公司专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的研发，核心技术持续迭代演进，保持业内领先。对于端侧 AI 硬件，无线连接是最基本的需求，公司可穿戴 SoC 芯片集成 Wi-Fi6 与蓝牙双模通信系统，并在低功耗蓝牙与 Wi-Fi 技术上持续演进，致力于为智能可穿戴与智能硬件产品提供最佳的无线连接体验。感谢您的关注。</p> <p>6、6100 的预计算力能到什么量级，比起 2800 系产品提升了多少，预计能有多少回馈。针对除了 AI 眼镜的泛 AI 硬件产品，我们的策略是沿用或者下放 2800 还是 6100 的子型号呢</p> <p>尊敬的投资者，您好！BES6100 芯片集成多核 Cortex-A 处理器、多核 NPU 与 GPU，综合算力较上一代可穿戴芯片 BES2800 大幅提升，可满足 Linux/Android 系统运行及端侧 AI 模型的推理需求。面向 AI 硬件市场，公司将在核心技术上持续迭代演进，推出合适的芯片产品，以满足不同市场与客户的需求。感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 4 月 29 日